杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年非公开发行股票预案

Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd

（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

二〇二一年三月

声 明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）有关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票数量不超过 120,174,000 股，在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

5、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

6、本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 520,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资金额（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施主体
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	衢州	346,005.00	228,800.00	金瑞泓微电子
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00	立昂微
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00	衢州金瑞泓
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00	
合计			642,365.00	520,000.00	

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

7、本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

8、本次发行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的规定，公司已在本预案“第五节 公司利润分配情况”中对公司利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年股东回报规划等进行了完整、清晰、明确的说明，请投资者予以关注。

10、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会发布的《关于回报并购重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”。

释 义

发行人、公司、本公司、上市公司、立昂微	指	杭州立昂微电子股份有限公司
金瑞泓微电子	指	金瑞泓微电子（衢州）有限公司
衢州金瑞泓	指	金瑞泓科技（衢州）有限公司
弘祥投资	指	仙游弘祥企业管理合伙企业（有限合伙）
弘万投资	指	仙游弘万企业管理合伙企业（有限合伙）
本次发行、本次非公开发行	指	杭州立昂微电子股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票的行为
公司章程、章程	指	杭州立昂微电子股份有限公司章程
本预案	指	杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年非公开发行股票预案
股东大会	指	杭州立昂微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州立昂微电子股份有限公司董事会
监事会	指	杭州立昂微电子股份有限公司监事会
高管人员、高管	指	杭州立昂微电子股份有限公司的高级管理人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第 一 节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	杭州立昂微电子股份有限公司
英文名称	Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd
上市地点	上海证券交易所
证券简称	立昂微
证券代码	605358
注册资本	400,580,000 人民币元
法定代表人	王敏文
成立日期	2002 年 3 月 19 日
上市日期	2020 年 9 月 11 日
住所	杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号
邮政编码	310018
电话	0571-86597238
传真	0571-86729010
公司网址	www.li-on.com
电子信箱	lionking@li-on.com
经营范围	半导体芯片的制造；半导体芯片的测试、封装；半导体专用部件、设备的制造。半导体芯片及封装产品的开发、销售；集成电路设计；半导体专用部件、设备的销售及技术咨询服务；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
主营业务	半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、国内半导体硅片产业面临重大发展机遇

得益于 5G 移动通信、物联网、人工智能、云计算、大数据等技术的快速发展和模拟化应用，智能手机、便携式设备、汽车电子等下游终端的芯片需求快速增长。为满足持续增加的芯片需求，全球主要芯片制造企业不断加大资本支出，提升终端市场生产能力。

据 SEMI 预计，2020 年至 2024 年全球将新增 30 余家 300mm（12 英寸）芯片制造厂。在全球芯片制造企业不断扩张的市场背景下，作为芯片制造的关键原材料，半导体硅片的市场需求量将明显增加，国内半导体硅片企业也将迎来发展的重要“时间窗口”。

近年来，在中国政府的高度重视和支持下，我国半导体行业在产业链各环节的技术水平和生产能力都取得了长足的发展。但相对而言，半导体硅片制造仍是我国半导体产业较为薄弱的环节。

半导体硅片制造具有资金投入大、技术门槛高、客户认证周期长的特点，且全球半导体硅片市场长期处于垄断格局，中国大陆半导体硅片企业在光论在技术积累还是市场占有率方面，均与国际成熟半导体硅片企业有较大差距。国内半导体硅片，特别是面向先进制程应用的 300mm（12 英寸）半导体硅片产重依赖进口，半导体硅片的国产化进程严重滞后于国内快速增长的市场需求。

2、功率半导体市场需求稳定增长

随着时代发展，功率半导体的应用范围进一步拓宽，已从传统的工业控制和 4C 产业（计算机、通信、消费类电子产品和汽车）扩展到新能源、轨道交通、智能电网等新领域，市场规模稳步增长。根据 Omida 统计，2021 年全球功率半导体市场规模预计将达到 441 亿美元，中国功率半导体市场需求规模预计将达到 159 亿美元，均保持稳定增长。

公司的功率半导体芯片主要应用于太阳能电池、开关电源、汽车以及手机等领域。随着汽车电动化、智能化的发展，功率半导体在车用半导体中的价值量将不断提升，带动公司的肖特基二极管芯片、MOSFET 芯片等功率半导体的需求持续上涨。相比于传统汽车，新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路，新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍，同时功率半导体用量比例也从 20%提升到近 50%；而在太阳能电池、手机等其他应用领域，下游需求的增加也在不断推动功率半导体行业的发展。

3、发展半导体产业为国家重点战略

半导体行业的发展程度是国家科技实力的重要体现，是信息化社会的支柱产业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。发展我国半导体相关产业，是我国成为世界制造强国的必经之路。近年来，国家各部门持续出台了一系列优惠政策来鼓励和支持集成电路行业发展。2014 年，国务院等部委颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2020 年 8 月 4 日，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇。

（二）本次非公开发行的目的

本次非公开发行股票募集资金使用围绕公司主营业务展开，通过实施募投项目丰富产品种类、扩大产品产能，完善产业布局，提升公司综合竞争能力。“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”项目实施后将实现 12 英寸半导体硅片的大批量生产，提高在半导体硅片主流市场的份额；“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”将使得公司沟槽肖特基功率二极管芯片的产品结构、增强市场竞争力；“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”针对下游市场的需求，进一步提高相关产品的产能和市场占有率，以期巩固和提升公司在功率器件市场的竞争力。

通过此次发行，公司将增加资本实力，补充公司业务发展所需资金，丰富公司产品类型，提高生产能力，增强公司营运能力、提升盈利水平，进一步夯实公司在行业中的市场地位，并为公司未来的战略实施提供有力支撑。

3、发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

本次发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

（二）发行对象与公司关系

截至本预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向不超过 35 名的特定投资者发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（三）定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）有关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

（四）发行对象认购方式

本次发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订稿）规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 120,174,000 股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

（六）限售期

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

（七）募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 520,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	建设地点	投资金额（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施主体
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	衢州	346,005.00	228,800.00	金瑞泓微电子
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00	立昂微
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00	衢州金瑞泓
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00	
合计			642,365.00	520,000.00	

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

7、本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

8、本次发行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的规定，公司已在本预案“第五节 公司利润分配情况”中对公司利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年股东回报规划等进行了完整、清晰、明确的说明，请投资者予以关注。

10、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会发布的《关于回报并购重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”。

释义

发行人、公司、本公司、上市公司、立昂微	指	杭州立昂微电子股份有限公司
金瑞泓微电子	指	金瑞泓微电子（衢州）有限公司
衢州金瑞泓	指	金瑞泓科技（衢州）有限公司
弘祥投资	指	仙游弘祥企业管理合伙企业（有限合伙）
弘万投资	指	仙游弘万企业管理合伙企业（有限合伙）
本次发行、本次非公开发行	指	杭州立昂微电子股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票的行为
公司章程、章程	指	杭州立昂微电子股份有限公司章程
本预案	指	杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年非公开发行股票预案
股东大会	指	杭州立昂微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州立昂微电子股份有限公司董事会
监事会	指	杭州立昂微电子股份有限公司监事会
高管人员、高管	指	杭州立昂微电子股份有限公司的高级管理人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第 一 节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	杭州立昂微电子股份有限公司
英文名称	Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd
上市地点	上海证券交易所
证券简称	立昂微
证券代码	605358
注册资本	400,580,000 人民币元
法定代表人	王敏文
成立日期	2002 年 3 月 19 日
上市日期	2020 年 9 月 11 日
住所	杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号
邮政编码	310018
电话	0571-86597238
传真	0571-86729010
公司网址	www.li-on.com
电子信箱	lionking@li-on.com
经营范围	半导体芯片的制造；半导体芯片的测试、封装；半导体专用部件、设备的制造。半导体芯片及封装产品的开发、销售；集成电路设计；半导体专用部件、设备的销售及技术咨询服务；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
主营业务	半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、国内半导体硅片产业面临重大发展机遇

得益于 5G 移动通信、物联网、人工智能、云计算、大数据等技术的快速发展和模拟化应用，智能手机、便携式设备、汽车电子等下游终端的芯片需求快速增长。为满足持续增加的芯片需求，全球主要芯片制造企业不断加大资本支出，提升终端市场生产能力。

据 SEMI 预计，2020 年至 2024 年全球将新增 30 余家 300mm（12 英寸）芯片制造厂。在全球芯片制造企业不断扩张的市场背景下，作为芯片制造的关键原材料，半导体硅片的市场需求量将明显增加，国内半导体硅片企业也将迎来发展的重要“时间窗口”。

近年来，在中国政府的高度重视和支持下，我国半导体行业在产业链各环节的技术水平和生产能力都取得了长足的发展。但相对而言，半导体硅片制造仍是我国半导体产业较为薄弱的环节。

半导体硅片制造具有资金投入大、技术门槛高、客户认证周期长的特点，且全球半导体硅片市场长期处于垄断格局，中国大陆半导体硅片企业在光论在技术积累还是市场占有率方面，均与国际成熟半导体硅片企业有较大差距。国内半导体硅片，特别是面向先进制程应用的 300mm（12 英寸）半导体硅片产重依赖进口，半导体硅片的国产化进程严重滞后于国内快速增长的市场需求。

2、功率半导体市场需求稳定增长

随着时代发展，功率半导体的应用范围进一步拓宽，已从传统的工业控制和 4C 产业（计算机、通信、消费类电子产品和汽车）扩展到新能源、轨道交通、智能电网等新领域，市场规模稳步增长。根据 Omida 统计，2021 年全球功率半导体市场规模预计将达到 441 亿美元，中国功率半导体市场需求规模预计将达到 159 亿美元，均保持稳定增长。

公司的功率半导体芯片主要应用于太阳能电池、开关电源、汽车以及手机等领域。随着汽车电动化、智能化的发展，功率半导体在车用半导体中的价值量将不断提升，带动公司的肖特基二极管芯片、MOSFET 芯片等功率半导体的需求持续上涨。相比于传统汽车，新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路，新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍，同时功率半导体用量比例也从 20%提升到近 50%；而在太阳能电池、手机等其他应用领域，下游需求的增加也在不断推动功率半导体行业的发展。

3、发展半导体产业为国家重点战略

半导体行业的发展程度是国家科技实力的重要体现，是信息化社会的支柱产业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。发展我国半导体相关产业，是我国成为世界制造强国的必经之路。近年来，国家各部门持续出台了一系列优惠政策来鼓励和支持集成电路行业发展。2014 年，国务院等部委颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2020 年 8 月 4 日，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇。

（二）本次非公开发行的目的

本次非公开发行股票募集资金使用围绕公司主营业务展开，通过实施募投项目丰富产品种类、扩大产品产能，完善产业布局，提升公司综合竞争能力。“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”项目实施后将实现 12 英寸半导体硅片的大批量生产，提高在半导体硅片主流市场的份额；“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”将使得公司沟槽肖特基功率二极管芯片的产品结构、增强市场竞争力；“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”针对下游市场的需求，进一步提高相关产品的产能和市场占有率，以期巩固和提升公司在功率器件市场的竞争力。

通过此次发行，公司将增加资本实力，补充公司业务发展所需资金，丰富公司产品类型，提高生产能力，增强公司营运能力、提升盈利水平，进一步夯实公司在行业中的市场地位，并为公司未来的战略实施提供有力支撑。

3、发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

本次发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

（二）发行对象与公司关系

截至本预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向不超过 35 名的特定投资者发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（三）定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）有关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

（四）发行对象认购方式

本次发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订稿）规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 120,174,000 股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

（六）限售期

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

（七）募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 520,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	建设地点	投资金额（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施主体
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	衢州	346,005.00	228,800.00	金瑞泓微电子
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00	立昂微
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00	衢州金瑞泓
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00	
合计			642,365.00	520,000.00	

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

（八）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。

（九）上市地点

本次非公开发行股票在上海证券交易所上市交易。

（十）决议有效期

本次非公开发行决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，主承销商接持有公司 19.88%股份，为公司控股股东。同时，王敏文先生通过泓祥投资和泓万投资间接控制公司 8.81%的股份。王敏文先生合计控制公司 28.69%的股份，为公司实际控制人。

按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，王敏文先生直接持有的股份比例将不低于 15.29%，王敏文先生仍为公司控股股东。同时，王敏文先生通过泓祥投资和泓万投资间接控制公司的股份比例不低于 6.77%。王敏文先生合计控制的股份比例不低于 22.06%，仍为公司实际控制人。

因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否导致股权分布不符合上市条件

本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于 10%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。

八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议以及中国证监会核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票登记、发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部申报和批准程序。

第 二 节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过人民币 520,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	建设地点	投资金额（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施主体
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	衢州	346,005.00	228,800.00	金瑞泓微电子
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00	立昂微
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00	衢州金瑞泓
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00	
合计			642,365.00	520,000.00	

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片

1、项目概况

本项目拟投资 346,005.00 万元，由金瑞泓微电子作为实施主体，在扣除金瑞泓微电子已以自有资金投入的资金后，本次拟以募集资金投入 228,800.00 万元，租赁衢州金瑞泓现有厂房，购置单晶炉、抛光机、减薄机、清洗机、几何参数测试仪、外延炉等先进设备，建设“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”项目。项目完全达产后，预计将拥有年产集成电路用 12 英寸硅片 180 万片的生产能力，预计每年将实现销售收入 152,070.00 万元。

2、项目实施的背景及必要性

（1）半导体硅片市场快速发展，大尺寸硅片仍占据主流

半导体硅片是占比最大的集成电路制造材料，根据 SEMI 统计，历年来半导体硅片的市场销售额占整个半导体材料市场总销售额的 32%–40%，半导体硅片的供应与价格变动对集成电路芯片产业存在较大影响。2017 年以来，受益于半导体终端市场需求强劲，下游传统应用领域计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长，新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、汽车电子的快速发展，半导体硅片市场规模不断增长，并于 2018 年突破百亿美元大关，达到 114 亿美元；2019 年，市场规模仍维持在 112